

深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表

证券简称：联得装备

证券代码：300545

编号：2024-011

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 _____
参与单位名称及人员姓名	光大证券、德邦证券等 2 位机构投资人
时间	2024 年 7 月 26 日
地点	东莞联鹏智能装备有限公司厂区及会议室
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书：刘雨晴女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、介绍公司概况</p> <p>简要介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩，公司及子公司的核心优势及未来发展规划等情况。</p> <p>二、投资者会议问答交流</p> <p>Q1：公司主要生产哪些设备？</p> <p>A1：公司主要从事新型半导体显示智能装备、汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备、新能源设备的研发、生产、销售及服务。公司主要产品包括绑定设备、贴合设备、偏贴设备、检测设备、大尺寸 TV 整线设备、移动终端自动化设备、汽车智能座舱系统组装设备、Mini/Micro LED 芯片分选设备、扩晶设备、真空贴膜设备、巨量转移设备、半导体倒装设备、固晶设备、AOI 检测设备、引线框架贴膜设备、锂电池模切叠片设备、电芯装配段及 pack 段整线自动化设备。</p> <p>Q2：请简单介绍一下公司的生产模式？</p> <p>A2：公司的设备生产实行“以销定产”的生产模式。公司的产品具有较</p>

为鲜明的定制化特点，产品生产需根据客户不同的设计方案、材料选择、性能、规格等进行定制化生产。

Q3：公司在半导体领域的主要设备有哪些？

A3：公司在半导体领域主要生产半导体后段工序的封装测试设备。主要产品是 COF 倒装机、半导体倒装机、软焊料固晶机、共晶固晶机、AOI 检测机、引线框架贴膜机等高速高精的半导体装备。在先进封装领域公司有针对显示驱动芯片键合设备，COF 倒装设备，该倒装设备是一种采用共晶+倒装的芯片键合工艺的高精度高速度先进封装设备。公司将密切关注行业发展动态和前沿技术的发展趋势，积极创造并把握半导体设备领域的发展机遇。

Q4：公司在 VR/AR/MR 显示领域有哪些产品和客户？

A4：公司通过不断推陈出新打破技术壁垒，持续自主研发创新，研发的设备已经赢得了 VR/AR/MR 等新型显示领域客户的青睐。在 VR/AR/MR 显示设备领域，公司提供其显示器件生产工艺中所需的设备，相关产品已与合肥视涯等客户建立了合作关系。

Q5：在 Mini/Micro LED 领域，公司有研发哪些设备？

A5：公司目前在 Mini/Micro LED 显示领域，已经推出芯片分选设备、芯片扩晶设备、检测设备、真空贴膜设备、芯片巨量转移设备、高精度拼接设备等。

Q6：公司在海外市场拓展情况如何？

A6：在海外市场，公司积累了如大陆汽车电子、博世、伟世通等诸多世界 500 强的客户资源，并建立了良好的合作关系。公司在该行业的布局逐渐在订单中变现，特别是公司与国外大客户的深度合作，实现了设备在欧洲、东南亚、北美的落地。

Q7：公司未来有何规划？

A7：公司将持续加强在半导体显示模组设备、汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备及新能源装备领域的研发。积极开拓柔性显示模组设备及显示前端工序贴合类设备、Mini/Micro LED 设备、VR/AR/MR 精密组装设备、汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备以及新能源装备在新兴领域

	的应用市场，同时继续加大这些领域的新技术、新产品研发力度，支撑该业务快速成长。
附件清单（如有）	无
日期	2024-7-26